

investor

newsletter

IM FOKUS

- 2 ■ Energiefressern Beine machen

TRENDS & THEMEN

- 3-4 ■ Nachfrage steigt:
Halbleiterwerke werden ausgebaut
- China: Alles auf einer Karte
- Strategisch:
Telefonnetze fit fürs Breitband machen
- Tastatur im Ärmel:
Limitierte Jackenaufgabe ab August
- Zwei Geschäftsbereiche
mit neuer Führungsspitze

ENTWICKLUNG & PRODUKTE

- 5-7 ■ Neues Speichermodul:
Kleine Notebooks – große Leistung
- Flache Speicherriesen
für Server und flache Laptops
- Im Eiltempo von analog auf digital
- Höhere Speicherdichte:
Durchbruch für Magnetchips
- Seitenairbag bei Überschlag:
Neue Autosensoren
- Mit Infineon ins Breitbandnetz
- Gold für digitalen Rundfunk
und digitales Fernsehen

ZAHLEN & FAKTEN

- 8-11 ■ Analyse der Geschäftsergebnisse

AUSBLICK

- 11-12 ■ Ausblick für das vierte Quartal
des Geschäftsjahrs 2004
- Relative Entwicklung der IFX-Aktie
seit Beginn des Geschäftsjahrs 2002

Sieht nicht nur futuristisch aus:

Die neue Herrenjacke
mit eingebauter MP3-Musik
und Bluetooth-Telefon.
Mehr dazu auf Seite 4.



ENERGIEFRESSERN BEINE MACHEN

Neuer Chipsatz reduziert Stromverschwendung im Standby-Betrieb und erhöht den Wirkungsgrad von Netzteilen

Der hohe Ölpreis macht viele Menschen nachdenklich und lässt nach Stromfressern im Haushalt Ausschau halten. Da sind zum einen die offensichtlichen Großverbraucher Kühlschrank, Waschmaschine und Trockner. Wenig beachtet werden dagegen Netzteile, die den Steckdosenstrom für DVD-Spieler, LCD-Monitore oder tragbare Geräte in gut verdaulichen Gleichstrom transferieren oder Akkus nachladen. Doch sie ziehen still und leise erkleckliche Energiemengen, auch im Standby-Betrieb, und dabei kommt ganz schön was zusammen: Geräte mit Netzteilen verbrauchen in Industrienationen etwa 6 Prozent des Stroms. In Deutschland macht das rund 30 Millionen Megawattstunden pro Jahr – Tendenz steigend.

Stecker raus oder – falls überhaupt vorhanden – Netzschalter drücken – nur das verhindert, dass im Standby-Betrieb Energie als Wärme verloren geht. Bisher jedenfalls, denn jetzt wartet Infineon mit einer Alternative auf, die künftig in Deutschland ein ganzes Kernkraftwerk überflüssig machen könnte – rechnerisch zumindest. Das Zeug dazu hat der CoolSET F3-Chipsatz. Der hat einen erheblich verbesserten Wirkungsgrad, so dass mehr Energie dort ankommt, wo sie gebraucht wird. Auch im Standby-Betrieb gibt sich das CoolSET für Netzteile genügsam: Mit 75 Milliwatt verbraucht es nur halb so viel wie bisherige Spitzenreiter.

Das Geheimnis dahinter liegt in der Bauweise: Der Logikchip, der die Steuerung übernimmt, zieht in ein gemeinsames Gehäuse mit dem Leistungstransistor, der für die Stromverteilung zuständig ist. Das spart Platz, reduziert den Widerstand und damit den Wärmeverlust. Damit schreibt

Infineon fort, wofür das Unternehmen mit dem Innovationspreis der Deutschen Wirtschaft 2001 geehrt wurde: Stromsparende Bauteile, die dem Komfort keinerlei Abstriche abverlangen. Das CoolSET beruht auf dem seinerzeit ausgezeichneten CoolMOS-Prinzip, mit dem hervorragendes Leiten und perfektes Isolieren im gleichen Bauelement vereint sind – Eigenschaften, die sich eigentlich wie Feuer und Wasser widersprechen. So lassen sich Energieflüsse außerordentlich präzise regeln, bei äußerst geringer Abwärme.

Das CoolSET F3 markiert nun einen neuen Meilenstein – und geht dabei sogar über strenge Umweltstandards hinaus: Bei der Leistungsaufnahme liegt es im Wettbewerbsvergleich am niedrigsten und unterbietet die Spezifikationen des deutschen blauen Umweltengels (www.blauer-engel.de) ebenso wie die des US-amerikanischen Energy-Star-Programms (www.energystar.gov). Ein typischer DVD-Spieler etwa, der im Betrieb ungefähr 30 Watt braucht, kommt im

Standby-Betrieb mit nur noch 100 Milliwatt aus – ein Fünftel der 500 Milliwatt, die sowohl Energy Star als auch europäische Energiekommission zulassen. Zunächst eignet sich der Infineon-Chip für Geräte mit einer Leistung von bis zu 100 Watt – also beispielsweise Notebooks, LCD-Monitore, DVD-Spieler oder Videokameras. Später soll die Palette ausgeweitet werden.

Daneben erleichtert das CoolSET F3 das Leben auch im wörtlichen Sinn: Mit seiner hohen Energie-Effizienz lassen sich kleinere und leichtere Netzteile bauen. Das wiederum reduziert das Gewicht von Mobilgeräten, wenn unterwegs Akkus nachgeladen werden sollen. Und der Strom ist schneller und mit konstanter Stromstärke verfügbar, auch bei Spannungsschwankungen. Das ist zum Beispiel bei DVD-Spielern wichtig – zwischen Abspielen, schnellem Vorlauf und Aufnahme ändert sich die Leistungsaufnahme schnell.

Und noch etwas lehrt das CoolSET, indem es heimlichen Stromfressern Einhalt gebietet: Neue Entwicklungen führen nicht zwangsläufig dazu, dass mehr Energie verbraucht wird. Gelegentlich können sie substanzial dazu beitragen, Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu schützen.

**Bringt den Strom dahin, wo er hingehört,
lässt kaum Wärme verloren gehen
und schont die Umwelt: Das CoolSET F3.**



NACHFRAGE STEIGT: HALBLEITERWERKE WERDEN AUSGEBAUT



Chips sind wieder in größerer Zahl gefragt – und Infineon expandiert. Das Werk in Porto, in dem Speicherchips getestet und montiert werden, wird erweitert.

Infineon reagiert auf die steigende Nachfrage nach Logik- und Speicherchips: Die Kapazitäten der Halbleiterwerke in Richmond, USA, und im portugiesischen Porto werden ausgebaut. In Richmond wird ein Produktionsmodul für die Fertigung auf 300-Millimeter-Wafern mit Geräten ausgestattet. Ab Anfang 2005 sollen dort monatlich etwa 25.000 Wafer-Starts möglich sein, womit

am Standort mehr als doppelt so viele DRAM-Chips wie bisher entstehen werden. Neben diesem Erweiterungsprojekt, in das eine Milliarde US-Dollar investiert wird, steckt Infineon 230 Millionen Euro in seine Fabrik in Porto: Hier werden die Wafer, die mit fertigen Chips aus den Werken Dresden und Richmond kommen, weiterverarbeitet. In der portugiesischen Stadt werden ab Mitte 2006 bis zu 600 Millionen Chips pro Jahr zusätzlich montiert und getestet. Das ist ebenfalls doppelt so viel wie bisher oder 30 bis 40 Prozent der weltweiten Speicherchipproduktion von Infineon. In Porto entstehen so etwa 500, in Richmond 800 neue Arbeitsplätze.

Feierstimmung: Dr. Michael Majerus, Chief Financial Officer des Geschäftsbereichs Speicherprodukte, bei der Einweihung des neuen Moduls.

Hoher Besuch:

José Manuel Durão Barroso, portugiesischer Premierminister, erweist Infineon die Ehre.



CHINA: ALLES AUF EINER KARTE

ZTE, Chinas größter börsennotierter Hersteller von Telekommunikations-equipment, greift bei seinen neuen Anschlusskarten für Breitbandvermittlungstellen (Linecards) auf Know-how von Infineon zurück. Diese integrierten Sprach- und Daten-Linecards sind mit Infineon-Chipsätzen ausgestattet und bilden eine Hardware-Plattform, die sowohl konventionelle Telefonanschlüsse als auch ADSL-Zugang bietet. Zwei getrennte Systeme sind somit überflüssig – dadurch sinken Installationskosten und Wartungsaufwand. Gerade in weniger erschlossenen Regionen Chinas, in denen ein wachsender Bedarf sowohl an Telefon- als auch an Breitbandanschlüssen besteht, ist das Single-Linecard-Konzept interessant. ZTE hatte zuvor bereits Resilient-Packet-Ring-Lösungen von Infineon geordert, mit denen Metropolitan und Wide Area Networks ausgerüstet werden.

STRATEGISCH: TELEFONNETZE FIT FÜRS BREITBAND MACHEN

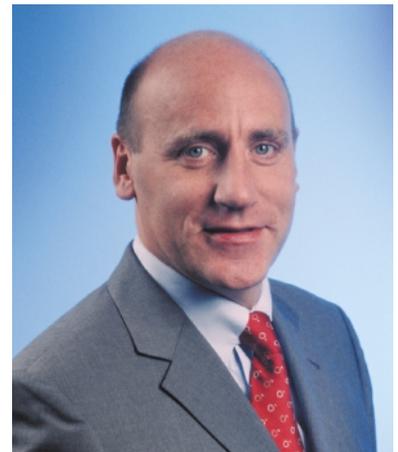
Konventionelle Telefoninfrastruktur hat sich inzwischen fast überall durchgesetzt – sie für die großen Datenpakete fit zu machen, die per Breitband verschickt werden, diesen Anspruch erhebt Infineon jetzt zur Strategie. Damit Systemhersteller das schnell und kostengünstig bewerkstelligen können, ist das Konzept „Cost Efficient Data Transport“ entstanden. Dabei stellt Infineon seinen Kunden all jene Produkte und Technologien bereit, die sie brauchen, um über herkömmliche Telefonnetze moderne Breitbanddienste laufen zu lassen – von Voice-over-Internet Protocol über Audio-/Video-Übertragungen bis hin zu virtuellen Privatnetzen. Das soll bedarfsgerecht und ohne hohe Anfangskosten möglich sein. Das erste Produkt, das diesem Anspruch gerecht wird, ist der so genannte MetroMapper 2.5G: Er erlaubt Herstellern von Daten- und traditionellen Telekommunikationsgeräten, flexible Systeme zu entwickeln, die den neuesten Ethernet-Transportanforderungen gerecht werden.

TASTATUR IM ÄRMEL: LIMITIERTE JACKENAUFLAGE AB AUGUST

Ab dem 1. August wirbt der BekleidungsHersteller rosner für eine limitierte Auflage elektronischer Herrenjacken, für die Infineon den elektronischen Anteil beisteuert. Und die Jacke hat es in sich: Sie hört auf den Namen mp3blue – und erlaubt ihrem Träger, mobil per Bluetooth zu telefonieren und Musik per MP3-Player zu hören. In Stoffbahnen sind elektrische Leitungen unauffällig eingewebt, die Tastaturtasten dazu sind auf dem Ärmel aufgedruckt. Im Kragen sind Kopfhörer angeschlossen und ein Mikrofon ist integriert – wenn der Jackenträger telefonieren will, wandelt sich die Jacke zum Headset. Das Ganze ist waschmaschinentauglich; lediglich das Elektronikmodul muss aus seiner Halterung genommen werden. Ab August lässt sich ein solches Stück im Internet unter www.mp3blue.de erwerben. Studien der Venture Development Corporation gehen im Übrigen davon aus, dass der weltweite Umsatz für intelligente Textilien 2007 bei über einer Milliarde Euro liegen wird. Die Basistechnologie, die Infineon entwickelt hat, eröffnet neue Märkte und Absatzkanäle. Infineon hatte zuvor bereits eine Snowboard-Jacke mit dem Sportausrüster O'Neill auf den Weg gebracht, die in der Winterkollektion 2004/05 zu haben sein wird. Gemeinsam mit Vorwerk arbeitet Infineon zudem an elektronischen Teppichen.

ZWEI GESCHÄFTSBEREICHE MIT NEUER FÜHRUNGSSPITZE

Thomas Seifert (40), der bisher dem Geschäftsbereich Drahtgebundene Kommunikation vorstand, trägt seit dem 1. Juni die weltweite Verantwortung für das Speichergeschäft bei Infineon. Er löst Dr. Harald Eggers (54) ab, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch nach mehr als 25 Dienstjahren verlässt, um sich auf das Privatleben zu konzentrieren.



Thomas Seifert ist der neue Chef fürs Speichergeschäft.



Prof. Dr. Hermann Eul leitet zukünftig den Bereich Drahtgebundene Kommunikation.

Prof. Dr. Hermann Eul (45) übernimmt den Geschäftsbereich Drahtgebundene Kommunikation. Er hatte bis Ende 2002 an der Spitze des Bereichs Sicherheits- und Chipkarten ICs gestanden und war zwischenzeitlich von der Universität Hannover zum Professor und Leiter des Fachgebietes Hochfrequenztechnik und Funksysteme berufen worden.

Dr. Eggers wird noch bis Ende Dezember 2004 verschiedenen Unternehmensprojekten vorstehen und dem Unternehmen danach mit seiner langjährigen Expertise und seiner exzellenten weltweiten Vernetzung beratend zur Seite stehen.

NEUES SPEICHERMODUL: KLEINE NOTEBOOKS – GROSSE LEISTUNG

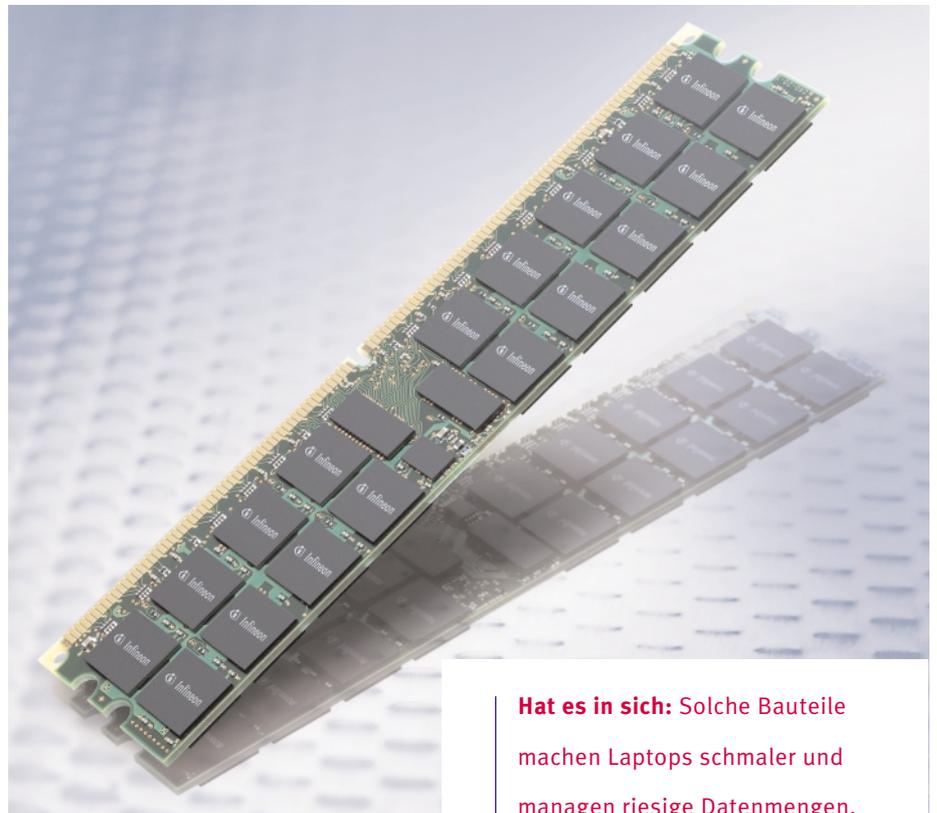
Kleine Notebooks holen auf: Dank des neuen Micro-DIMM-Speichermoduls müssen bei den so genannten Subnotebooks künftig weniger Kompromisse eingegangen werden. Subnotebooks wiegen

weniger als ein Kilo – das macht sie beliebt, auch wenn man sich bisher beschränken muss: Der Platz ist knapp, und dem muss das Innenleben aus Arbeitsspeicher, Batterie, Festplatte und DVD-Brenner Rechnung tragen. Bisher – denn das neue Modul, dessen Chips deutlich dichter als bislang üblich gepackt sind, spart 40 Prozent des Platzes und verbraucht

obendrein weniger Strom. Zu den ersten Kunden zählt das taiwanische Unternehmen Asus, einer der größten Hersteller von Computer-Mainboards. 256 und 512 Megabyte Micro-DIMMs werden ab September in großen Stückzahlen hergestellt, voraussichtlich Anfang des kommenden Jahres kommt die 1-Gigabyte-Variante hinzu.

FLACHE SPEICHERRIESEN FÜR SERVER UND FLACHE LAPTOPS

Schätzungen haben ergeben, dass auf der Welt jeden Tag rund 52 Milliarden Megabytes an Daten entstehen, mit steigender Tendenz. Damit riesige Informationsmengen sicher gespeichert, kostengünstig verwaltet und bei Bedarf den Applikationen schnell verfügbar gemacht werden, bedarf es leistungsfähiger Storage-Infrastrukturen. Dafür, aber auch für Server, die ebenfalls immer anspruchsvoller werden, hat Infineon Module mit einem neuen, planaren Aufbau vorgestellt: ein 2 Gigabyte DDR2 Modul und ein 1GB DDR2 So DIMM. Innovativ ist die Architektur: Da die Modulabmessungen genormt sind und nur eine bestimmte Anzahl von Chips darauf montiert werden können, musste man bisher ab einer gewünschten Dichte auf so genannte „gestapelte Chips“ zurückgreifen, also zwei oder mehrere Chips in einem einzigen, und damit dickeren Gehäuse. Dagegen werden beim planaren Aufbau herkömmliche Einzelchips auf den Modulen angebracht. Das 2 Gigabyte DDR2 Modul mit planarem Aufbau besteht aus 36 einzelnen 512-Megabit-Chips und ist nur 4,1 Millimeter dünn – im Gegensatz zu herkömmlichen Modulen mit gestapelten Chips, die bis zu sechs Zentimeter dick sein können. Es erfüllt alle Parameter für DDR2 Serverapplikationen und strahlt überdies bis zu 10 Prozent weniger Wärme ab, benötigt also auch weniger Strom für die Kühlung. Planar angeordnet ist auch der neue DDR2 Small outline DIMM (Dual Inline Memory Modules), ein 1 Gigabyte Speichermodul, das nur 3,8 Millimeter dünn ist und damit der nächsten Generation von noch flacheren Notebooks und Laptops entgegenkommt.



Hat es in sich: Solche Bauteile machen Laptops schmäler und managen riesige Datenmengen.

IM EILTEMPO VON ANALOG AUF DIGITAL

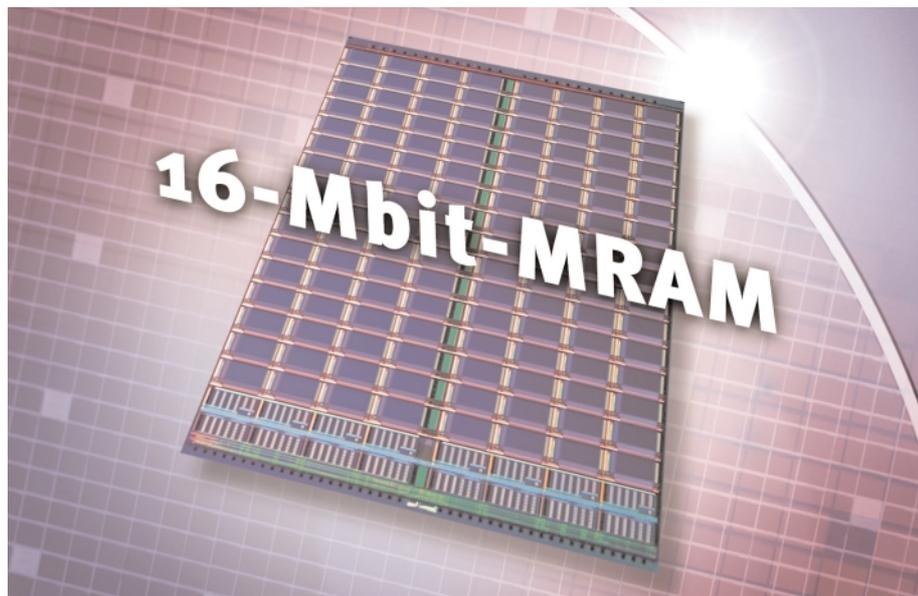
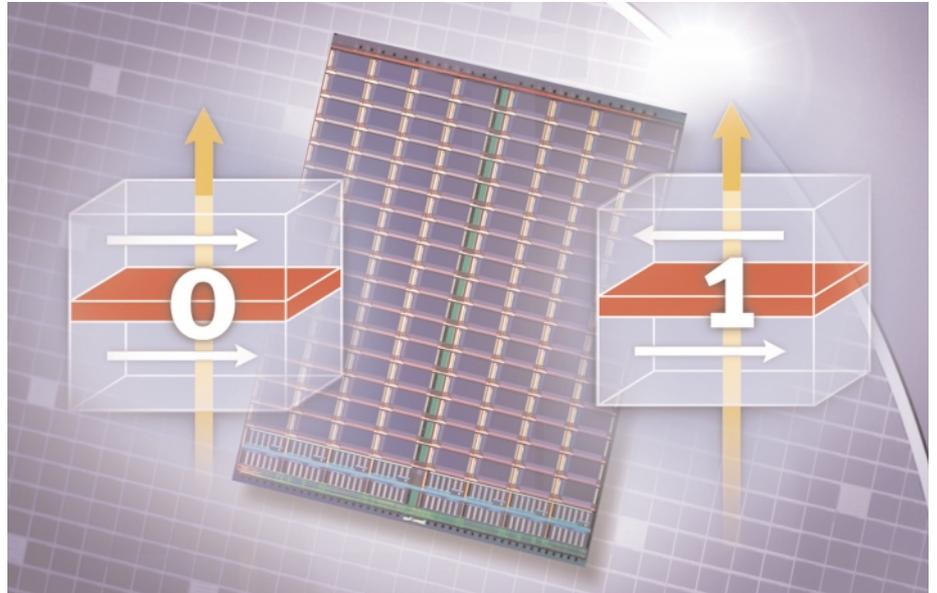
In Rekordgeschwindigkeit von analog zu digital – das schafft der 6-Bit-Flash-Analog-Digital-Wandler, den Infineon auf dem Fachsymposium VLSI Technologies and Circuits vorgestellt hat. Er gilt als wichtiger Meilenstein hin zu leistungsfähigen so genannten Mixed-Signal-Schaltungen, denen es obliegt, zwischen der analogen und der digitalen Welt zu vermitteln. Gebraucht werden solche so genannten Analog-Digital-Converter

(ADC) für nächste Generationen von Kommunikationsprodukten. Hergestellt werden sie in der kostengünstigen Standard-CMOS-Technologie (Complementare Metal Oxid Semiconductor), inzwischen der gängigen Technologie, um Logikchips mit geringem Stromverbrauch herzustellen. Die Abtastrate, in der die Auflösung des Signals angegeben wird, liegt mit vier Gigasamples pro Sekunde auf einem bislang nicht erreichten hohen Niveau.

HÖHERE SPEICHERDICHTE: DURCHBRUCH FÜR MAGNETCHIPS

Magnetische Speicherbausteine sind auf dem Vormarsch – sie müssen nicht ständig mit Strom versorgt werden, um Daten speichern zu können; sie sind zudem sehr schnell und erlauben nach dem Einschalten eines Computers den nahezu unmittelbaren Zugriff auf das Speichermedium. Infineon und IBM haben nun gemeinsam den weltweit ersten Magnetoresistive-RAM-Chip entwickelt, der es auf eine Speicherkapazität von

Co-Produktion: Infineon und IBM haben diesen Magnetchip gemeinsam entwickelt.



16 Megabit bringt – in dieser Technologie stellt das einen bisher unerreichten Wert dar. Der Prototyp, vorgestellt auf dem VLSI Symposium in Hawaii, ist 1000-mal schneller als die heute üblichen nicht-flüchtigen Flash-Speicher, wie sie etwa in USB-Sticks oder Pocket-Computern verwendet werden. MRAM, so die Abkürzung, gilt als vielversprechender Kandidat für universelle Speicher in tragbaren Geräten, deren Zahl ständig steigt.

Magnetischen Speicherbausteinen gehört die Zukunft – vor allem in tragbaren Geräten sind sie kaum zu schlagen.

SEITENAIRBAG BEI ÜBERSCHLAG: NEUE AUTOSSENSOREN

Eine ganze Palette neuer Sensoren für Autos hat Infineon auf der Fachmesse „Sensors Conference & Expo“ in Detroit präsentiert. Zwei der Neuvorstellungen – ein Sensor, mit dem der Reifendruck überwacht wird, und einer, der alarmiert, wenn sich ein Auto überschlägt, und dafür sorgt, dass die Seitenairbags auslösen und die Gurtstraffung aktiviert wird – kommen

von der norwegischen Firma SensoNor. Letztere wurde im vergangenen Jahr von Infineon übernommen und zählt zu den führenden Anbietern von Luftdruck- und Inertialsensoren.

Im Durchschnitt enthält jedes neue Kraftfahrzeug schon heute zwei Sensoren und 20 Mikrocontroller von Infineon.

Bei steigender Tendenz: Der Halbleitermarkt für Sicherheitsanwendungen im Auto werde in den nächsten vier Jahren im jährlichen Mittel um mehr als 10 Prozent wachsen, so das amerikanische Marktforschungsunternehmen Strategy Analytics.

MIT INFINEON INS BREITBANDNETZ

Für Breitbandnetze bietet Infineon zwei neue Lösungen, die den Datentransfer schneller und flexibler machen: Der ADSL2/2+-Chip Amazon unterstützt den schnellen drahtgebundenen Datentransfer vom globalen ins lokale Netz. Dabei ist er besonders für „Triple-Play“-Anwendungen geeignet, in denen Sprache, Video und Daten per Breitband über ein einziges Home Gateway übertragen werden, also über Schnittstellen, die Privathaushalte mit Netzapplikationen versorgen. Der Chipsatz WildCard macht drahtloses Ethernet-Networking mit Übertragungsraten von bis zu 54 Megabit pro Sekunde möglich. Interessant sind beide Produkte für Hersteller von DSL-Modems, von Homegateways, von Settop-Boxen, die Fernseher internettauglich machen, und schließlich von Routern, die verschiedene Netzwerke verbinden. Alle Bausteine der Home-Networking-Familie von Infineon lassen sich dabei nahtlos miteinander verknüpfen.



Drei Dinge auf einmal: Der Amazon-Chipsatz liefert Sprache, Video und Daten über eine einzige Schnittstelle nach Hause.

GOLD FÜR DIGITALEN RUNDFUNK UND DIGITALES FERNSEHEN



GOLDMOS macht Rundfunk und Fernsehen digital und steckt in Mobilfunkbasisstationen – mit überlegener Technologie in Gold.

Beim digitalen Radio und Fernsehen ebenso wie bei Mobilfunk-Basisstationen bedarf es einer leistungsfähigen Sprach- und Datenkommunikation. Dem nimmt sich Infineon mit einer neuen Generation von GOLDMOS-Leistungstransistoren an: Sie warten mit einer sehr hohen Bandbreite auf, mit einer um etwa 10 % verbesserten Betriebseffizienz und mit einem verringerten Memory-Effekt. Zudem bieten die Leistungstransistoren das industrieweit beste thermische Verhalten – was sie zu den zuverlässigsten Bauelementen am Markt macht. Hier spiegelt sich eine neue Prozesstechnologie, bei der die Infineon-Entwickler auf die Gold-Metallisierung gesetzt haben, wider. Erste Produktmuster werden ab dem dritten Quartal 2004 verfügbar sein, der Beginn der Serienproduktion ist für das vierte Quartal 2004 geplant.

ANALYSE DER GESCHÄFTSERGEBNISSE

DRITTES QUARTAL DES GESCHÄFTSJAHR 2004

- Quartalsumsatz verbesserte sich gegenüber dem Vorquartal um 14 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro
- Rückstellungen für DRAM-Wettbewerbsverfahren um 184 Millionen Euro erhöht
- Konzernfehlbetrag, nach Rückstellungen im dritten Quartal, von 56 Millionen Euro und EBIT von 2 Millionen Euro
- Der Konzernüberschuss vor Rückstellungen stieg im dritten Quartal deutlich auf 107 Millionen Euro, gegenüber 39 Millionen Euro im Vorquartal und einem Fehlbetrag von 116 Millionen Euro im Vorjahresquartal
- Das Quartals-EBIT vor Rückstellungen erhöhte sich auf 186 Millionen Euro, gegenüber 71 Millionen Euro im Vorquartal und einem EBIT-Verlust von 116 Millionen Euro im dritten Quartal des Vorjahrs
- Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit erhöhte sich auf über 500 Millionen Euro im dritten Quartal; der Free Cash Flow stieg signifikant auf 146 Millionen Euro

Infineon Technologies AG erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von 1.908 Millionen Euro, was einer Steigerung von 14 Prozent gegenüber dem Vorquartal und von 30 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum entspricht.

Infineon hat die Rückstellungen im Zusammenhang mit den laufenden Untersuchungen im DRAM-Wettbewerbsverfahren in den USA und Europa sowie möglichen Zivilklagen um 184 Millionen Euro auf 212 Millionen Euro erhöht. Diese Rückstellungen führten im dritten Quartal zu einem Konzernfehlbetrag von 56 Millionen Euro, im Vergleich zu einem Überschuss von 39 Millionen Euro im Vorquartal und einem Fehlbetrag von 116 Millionen Euro im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.

Der Verlust pro Aktie (verwässert und unverwässert) betrug im dritten Quartal 0,08 Euro gegenüber einem Gewinn pro Aktie von 0,05 Euro im vorausgegangenen Quartal. Ohne die Rückstellungen hätte der Gewinn pro Aktie 0,14 Euro betragen, gegenüber dem Vorjahresquartal mit einem Verlust von 0,16 Euro pro Aktie eine beträchtliche Steigerung.

AUSGEWÄHLTE DATEN DER QUARTALS-KONZERN-GEWINN-UND-VERLUSTRECHNUNG	3 MONATE ZUM	
	31.03.04	30.06.04
in Mio. Euro		
Umsatzerlöse	1.671	1.908
Bruttoergebnis vom Umsatz	557	695
Forschungs- und Entwicklungskosten	-304	-308
Vertriebskosten und allgemeine Verwaltungskosten	-176	-194
Aufwendungen für Umstrukturierungsmaßnahmen	-8	-5
Betriebsergebnis	68	5
Zinsergebnis	-8	-24
Auf konzernfremde Gesellschafter entfallende Ergebnisanteile	2	3
Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	63	-22
Erträge (Aufwendungen) aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-24	-34
Konzernüberschuss	39	-56
Gewichtete Anzahl ausstehender Aktien – unverwässert	723	748
Gewichtete Anzahl ausstehender Aktien – verwässert	733	748
Konzernüberschuss je Aktie – unverwässert und verwässert	0,05 €	-0,08 €
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	71	2

Umsatzerlöse

Die Zunahme im Vergleich zum Vorquartal erzielte das Unternehmen im Wesentlichen durch höhere Preise für Speicherprodukte sowie durch die gestiegene Nachfrage nach Produkten im Segment Sichere Mobile Lösungen.

Die Umsatzentwicklung der Geschäftsbereiche im dritten Quartal des Geschäftsjahrs 2004 im Vergleich zum Vorquartal

sowie zum dritten Quartal des Geschäftsjahrs 2003 ist wie folgt:

- Der Geschäftsbereich Automobil- und Industrieelektronik erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von insgesamt 415 Millionen Euro. Das entspricht einer Zunahme von 9 Prozent gegenüber dem Vorquartal und von 16 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorquartal wurde hauptsächlich

getragen durch die anhaltende Nachfrage nach Lösungen für die Automobilbranche und für Leistungselektronik sowie durch die positiven Entwicklungen im Geschäft mit AC/DC-Stromversorgungen.

■ Der Geschäftsbereich Drahtgebundene Kommunikation erreichte im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 104 Millionen Euro und damit 5 Prozent weniger als im Vorquartal sowie 13 Prozent weniger als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Infineon hat im dritten Quartal die Übernahme von ADMtek abgeschlossen und durch die Konsolidierung der ADMtek-Ergebnisse der letzten zwei Monate erstmals auch die Umsätze mit Breitband-CPE-Systemen (Customer Premises Equipment oder Breitband-Teilnehmeranschlusseinrichtungen) verzeichnet. Diese Umsätze konnten jedoch das rückläufige Geschäft mit optischen und Schmalband-Zugangs-Produkten nicht ausgleichen.

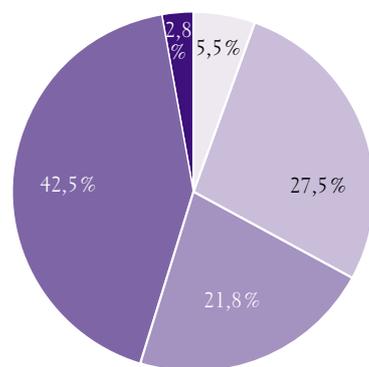
■ Der Geschäftsbereich Sichere Mobile Lösungen erzielte im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 525 Millionen Euro. Dieser Wert lag um 14 Prozent über dem des Vorquartals und um 38 Prozent über dem Umsatz des vergleichbaren Vorjahreszeitraums. Der Umsatz-zuwachs gegenüber dem Vorquartal ist im Wesentlichen auf das verbesserte Geschäft mit Sicherheitsprodukten und die höhere Nachfrage nach Produkten für mobile Lösungen, insbesondere in Europa und Asien, zurückzuführen.

■ Im Geschäftsbereich Speicherprodukte betrug der Umsatz im dritten Quartal 811 Millionen Euro und lag damit 22 Prozent über dem Wert des Vorquartals sowie 43 Prozent über dem Wert des vergleichbaren Vorjahreszeitraums. Der beträchtliche Umsatzzuwachs gegenüber dem Vorquartal ist im Wesentlichen auf höhere Durchschnittspreise für Chips zurückzuführen.

AUSGEWÄHLTE KONZERN-BILANZDATEN	ZUM	
	30.09.03	30.06.04
Aktiva	in Mio. Euro	
Zahlungsmittel	969	1.094
Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.784	1.536
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	876	1.073
Vorräte	959	886
Umlaufvermögen	5.306	5.176
Sachanlagen	3.817	3.555
Bilanzsumme	10.805	10.845
Passiva		
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	149	174
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	877	960
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten	2.134	2.326
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	2.343	2.060
Summe Verbindlichkeiten	5.139	4.915
Eigenkapital	5.666	5.930

AUSGEWÄHLTE DATEN DER QUARTALS-KAPITALFLUSSRECHNUNG	3 MONATE ZUM	
	31.03.04	30.06.04
	in Mio. Euro	
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	463	506
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-92	-34
Mittelabfluss/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit	-	-334
Abschreibungen	329	329
Mittelabfluss für Sachanlagen	-253	-271

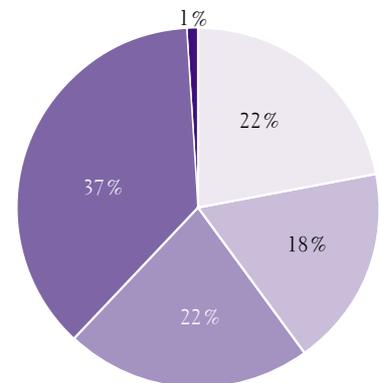
SEGMENT-UMSATZERLÖSE IN MIO. EURO UND PROZENT FÜR DAS QUARTAL ZUM 30.06.04



Drahtgebundene Kommunikation: 104 Mio. Euro
 Sichere Mobile Lösungen: 525 Mio. Euro
 Automobil- und Industrieelektronik: 415 Mio. Euro
 Speicherprodukte: 811 Mio. Euro
 Sonstige und Konzernfunktionen: 53 Mio. Euro

Infineon: 1.908 Mio. Euro

REGIONALE UMSATZVERTEILUNG IN PROZENT FÜR DAS QUARTAL ZUM 30.06.04



Deutschland
 Übriges Europa
 Nordamerika
 Asien-Pazifik
 Andere

■ Im Geschäftsbereich Sonstige betrug der Umsatz im dritten Quartal 45 Millionen Euro. Das entspricht einem Rückgang von 10 Prozent gegenüber dem Vorquartal und einer Steigerung von 25 Prozent im Vergleich zum Umsatz von 36 Millionen Euro, der im gleichen Zeitraum des Vorjahrs erreicht wurde.

Der außerhalb Europas erwirtschaftete Umsatz erreichte einen Anteil von 60 Prozent am Gesamtumsatz und stieg damit gegenüber dem Anteil von 58 Prozent im Vorquartal. Die Umsätze in Nordamerika machten, wie im Vorquartal, 22 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Im asiatischen Markt wurden 37 Prozent vom Gesamtumsatz erwirtschaftet, im vorausgegangenen Quartal waren es noch 35 Prozent.

Ergebnis

Das Quartals-EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) lag im abgelaufenen Quartal bei 2 Millionen Euro, gegenüber 71 Millionen Euro im Vorquartal und einem Verlust von 116 Millionen Euro im dritten Quartal des vergangenen Geschäftsjahrs. Ohne die zusätzlichen Rückstellungen hätte Infineon ein positives EBIT von 186 Millionen Euro im Quartal erzielt. Ursachen für das im Vergleich zum vorausgegangenen Quartal und zum Vorjahr verbesserte EBIT, ohne Berücksichtigung der Rückstellungen, waren hauptsächlich die höheren Chip-Preise im Segment Speicherprodukte sowie ein höheres Volumen und Produkti-

vitätssteigerungen im Segment Sichere Mobile Lösungen.

Der weltweite Halbleitermarkt hat im Verlauf der letzten drei Monate beträchtlich an Dynamik zugelegt. Dass Infineon – ohne die für das Wettbewerbsverfahren gebildeten Rückstellungen – von dieser Entwicklung profitieren konnte, spiegelt sich in den verbesserten Finanzergebnissen wider.

Die Ergebnisentwicklung der Geschäftsbereiche im dritten Quartal des Geschäftsjahrs 2004 im Vergleich zum Vorquartal sowie zum dritten Quartal des Geschäftsjahrs 2003 ist wie folgt:

- Das EBIT des Geschäftsbereichs Automobil- und Industrieelektronik verbesserte sich von 51 Millionen Euro im vorausgegangenen Quartal und 50 Millionen Euro im vergleichbaren Vorjahreszeitraum auf 58 Millionen Euro. Die Steigerung gegenüber dem Vorquartal kam im Wesentlichen durch das höhere Umsatzvolumen und die Vollausslastung der Fertigungskapazitäten zu Stande.
- Im Geschäftsbereich Drahtgebundene Kommunikation lag das EBIT bei minus 35 Millionen Euro, gegenüber einem Minus von 19 Millionen Euro im Vorquartal und einem Minus von 99 Millionen Euro im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Im EBIT des vergleichbaren Vorjahresquartals ist eine Wertminderung der immateriellen Vermögensgegenstände in Höhe von

68 Millionen Euro enthalten. Der EBIT-Rückgang gegenüber dem Vorquartal wurde hauptsächlich durch Aufwendungen in Verbindung mit der Akquisition von ADMtek und rückläufige Umsätze verursacht.

- Das EBIT des Geschäftsbereichs Sichere Mobile Lösungen stieg signifikant auf 47 Millionen Euro, gegenüber 27 Millionen Euro im vorausgegangenen Quartal und gegenüber einem Verlust von 18 Millionen Euro im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Das erhöhte Quartals-EBIT resultiert hauptsächlich aus dem gestiegenen Stückzahlvolumen, der verbesserten Produktivität, die zu geringeren Stückkosten geführt hat, und einem insgesamt optimierten Produktmix.
- Das EBIT des Geschäftsbereichs Speicherprodukte lag bei minus 50 Millionen Euro, gegenüber positiven 13 Millionen Euro im vorausgegangenen Quartal sowie positiven 3 Millionen Euro im gleichen Quartal des vorausgegangenen Geschäftsjahrs. Der EBIT-Rückgang gegenüber dem Vorquartal spiegelt eine Erhöhung der Rückstellung um 184 Millionen Euro in Verbindung mit den DRAM-Wettbewerbsverfahren wider, was auch durch höhere Chippreise nicht kompensiert werden konnte.
- Das EBIT im Geschäftsbereich Sonstige lag bei minus 3 Millionen Euro, gegenüber minus 17 Millionen Euro im Vorquartal und minus 15 Millionen Euro im dritten Quartal des Geschäftsjahrs 2003. Der im Vergleich zum vorausgegangenen Quartal geringere Fehlbetrag reflektiert hauptsächlich die niedrigeren Wertminderungen von Investitionen des Venture-Capital-Portfolios im abgelaufenen Quartal.
- Bei den Konzernfunktionen verzeichnete Infineon beim EBIT im dritten

EBIT	3 MONATE ZUM	
	31.03.04	30.06.04
	in Mio. Euro	
Drahtgebundene Kommunikation	-19	-35
Sichere Mobile Lösungen	27	47
Automobil- und Industrieelektronik	51	58
Speicherprodukte	13	-50
Sonstige und Konzernfunktionen	-1	-18
Infineon Konzern	71	2

Quartal ein Minus von 15 Millionen Euro. Im Vorquartal lag dieser Wert bei 16 Millionen Euro und im vergleichbaren Vorjahreszeitraum bei minus 37 Millionen Euro. Im EBIT des zweiten Quartals ist die Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 32 Millionen Euro für Lizenzgebühren berücksichtigt, die auf Grund einer günstigen Entscheidung in einem Rechtsfall nicht mehr erforderlich waren. Die positive Entwicklung im Jahresvergleich reflektiert im Wesentlichen die verbesserte Kapazitätsauslastung.

Aufwendungen

Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung betragen im dritten Quartal insgesamt 308 Millionen Euro oder 16 Prozent vom Umsatz. Im Vorquartal waren es 304 Millionen Euro oder 18 Prozent vom Umsatz. Die Zunahme in absoluten Zahlen resultiert vornehmlich aus erworbenen, nicht abgeschlossenen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Höhe von 9 Millionen Euro im Segment Drahtgebundene Kommunikation in Zusammenhang mit der Übernahme von ADMtek.

Die Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten beliefen sich im dritten Quartal auf 194 Millionen Euro oder 10 Prozent vom Umsatz, gegenüber 176 Millionen Euro oder 11 Prozent vom Umsatz im vorausgegangenen Quartal. Diese Ent-

wicklung reflektiert höhere, volumenabhängige Aufwendungen sowie einmalige Aufwendungen.

Ergebnisse der ersten neun Monate des Geschäftsjahrs 2004

Der Gesamtumsatz lag in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahrs 2004 mit 5.202 Millionen Euro um 18 Prozent über dem Gesamtumsatz von 4.396 Millionen Euro im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Der Konzernüberschuss der ersten neun Monate dieses Geschäftsjahrs betrug 17 Millionen Euro und verbesserte sich damit erheblich gegenüber einem Fehlbetrag von 484 Millionen Euro im gleichen Vorjahreszeitraum. Das EBIT für die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahrs stieg auf 143 Millionen Euro und verbesserte sich damit deutlich gegenüber dem EBIT von minus 366 Millionen Euro in den ersten neun Monaten des letzten Geschäftsjahrs. Ohne die im dritten Quartal gebildeten Rückstellungen hätte das Unternehmen einen Konzernüberschuss von 180 Millionen Euro und ein EBIT von 327 Millionen Euro in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahrs 2004 erzielt.

Liquidität

Der Free Cash Flow (Mittelzufluss aus laufender Geschäfts- und Investitionstätigkeit minus Mittelabfluss aus Investiti-

onstätigkeit, ohne Berücksichtigung der Effekte von Wertpapieren des Umlaufvermögens) erhöhte sich erheblich auf 146 Millionen Euro gegenüber 53 Millionen Euro im Vorquartal. Diese positive Entwicklung reflektiert den höheren Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit, der von 463 Millionen Euro im Vorquartal auf 506 Millionen Euro im dritten Quartal stieg. Die Brutto-Cash-Position (Zahlungsmittel, Wertpapiere des Umlaufvermögens und als Sicherheitsleistungen hinterlegte Zahlungsmittel) von Infineon lag mit 2,8 Milliarden Euro unter dem Wert des Vorquartals mit 2,9 Milliarden Euro. Während des dritten Quartals hat Infineon eigene Wandelanleihen mit Fälligkeit im Jahr 2007 im Nominalwert von 200 Millionen Euro abgelöst, was zukünftige Zinsaufwendungen reduziert.

Konzernstruktur

Im April 2004 hat Infineon eine Vereinbarung zum Verkauf seines Fiber-Optics-Geschäfts an die in den USA ansässige Finisar Corporation geschlossen. Die Transaktion wird voraussichtlich im vierten Quartal des Geschäftsjahrs 2004 abgeschlossen, vorbehaltlich der Zustimmung der Finisar-Aktionäre und Erfüllung weiterer Abschlussbedingungen. Im Mai 2004 hat Infineon die Übernahme der taiwanischen ADMtek abgeschlossen, welche ein Teil des Bereichs Drahtgebundene Kommunikation ist.

AUSBLICK FÜR DAS VIERTE QUARTAL DES GESCHÄFTSJAHRS 2004

In der Automobilindustrie sieht Infineon insgesamt keine gravierenden Veränderungen. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Preisdruck der Automobilhersteller anhalten wird, da sie zusätzliche Funktionen mit höherem Halbleiteranteil als Kaufanreiz anbieten, um den Absatz zu steigern. Auf Grund des saisonbedingten Wachstums des

PC-Markts, das sich auch auf das Segment Industrieelektronik auswirkt, und der frühen Investitionen in Kapazitätserweiterungen erwartet Infineon auch für das vierte Quartal des Geschäftsjahrs 2004 ein andauerndes moderates Wachstum für den Geschäftsbereich Automobil- und Industrieelektronik. Im Geschäftsbereich Drahtgebundene Kommunikation geht

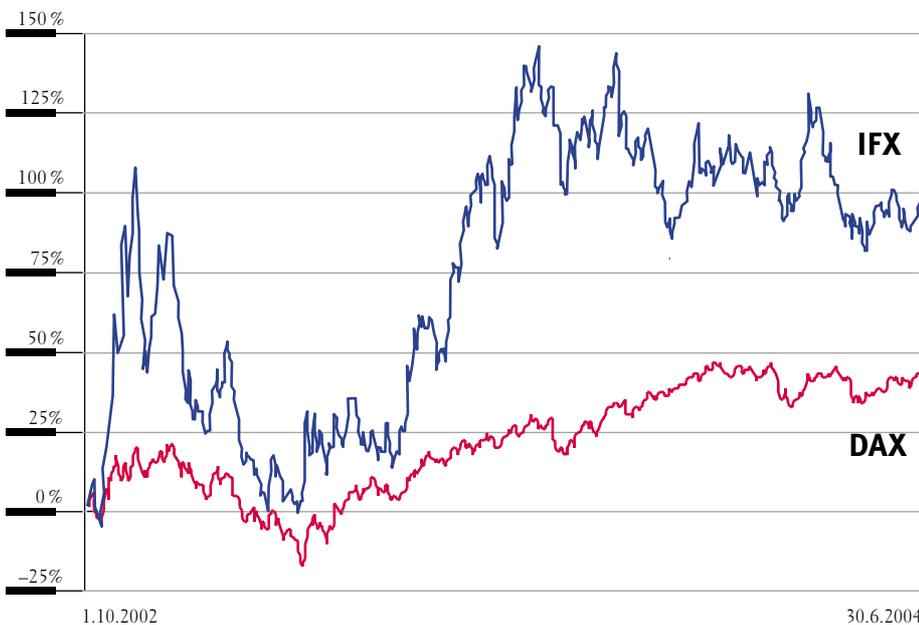
Infineon davon aus, dass die schwierigen Marktbedingungen auch im vierten Quartal des Geschäftsjahrs 2004 anhalten werden. Der Zuwachs in den Marktsegmenten ADSL, optische Netzwerke und CPE-Produkte wird voraussichtlich durch die weiterhin rückläufige Nachfrage nach konventionellen Telekommunikationsprodukten teilweise aufgehoben.

Infineon erwartet für das vierte Quartal des Geschäftsjahrs 2004 eine weiterhin positive Entwicklung für den Geschäftsbereich Sichere Mobile Lösungen. Durch eine saisonal bedingte starke Nachfrage wird der Umsatz mit mobilen Lösungen voraussichtlich weiterhin steigen. Auch die Kundennachfrage nach Basisband-ICs und RF-Transceivern dürfte sich voraussichtlich auf einem hohen Niveau halten, da nach Prognosen von Gartner der Absatz von Mobilfunktelefonen bis zum Ende des Jahres 2004 auf 600 Millionen Stück ansteigen wird. Im Jahr 2003 wurden 540 Millionen Mobilfunktelefone abgesetzt.

Für das vierte Quartal des Geschäftsjahrs 2004 erwartet Infineon auf Grund der saisonbedingten steigenden Nachfrage und der moderaten Steigerungen der Liefermengen in der Industrie eine positive Entwicklung von Angebot und Nachfrage für den Geschäftsbereich Speicherprodukte. Insgesamt geht Infineon davon aus, dass sowohl die Produktion als auch die Bit-Nachfrage ein solides Wachstum zeigen werden, das den Hochlauf der Produktion bei Inotera Memories sowie die Auswirkung der gestiegenen Lieferungen auf Basis der 110-Nanometer-Technologie reflektiert.

Das Ergebnis für das dritte Geschäftsquartal verdeutlicht, dass Infineon auf dem richtigen Weg ist. Alleine durch die Rückstellung im Rahmen der DRAM-Wettbewerbsverfahren wurde das Netto-Ergebnis ins Negative gedrückt. Damit wird verdeckelt, dass Infineon sonst ein sehr erfolgreiches Quartal erzielt hat. Infineon setzt auch weiterhin auf die langfristige, stabile und zuverlässige Kooperation mit ihren Kunden und Geschäftspartnern in der ganzen Welt. Für das vierte Quartal des Geschäftsjahrs 2004 erwartet Infineon weitere Zuwächse beim Umsatz sowie beim Konzernüberschuss.

Relative Entwicklung der Infineon-Aktie seit dem 1. Oktober 2002 (basierend auf den XETRA-Tagesschlusskursen; indiziert zum 30. September 2002):



INFINEON TECHNOLOGIES AG (XETRA)		DAX (XETRA)	
ERÖFFNUNG	11,29 EURO	ERÖFFNUNG	3.329,83
HOCH	13,65 EURO	HOCH	4.151,83
TIEF	10,14 EURO	TIEF	3.276,64
SCHLUSS	11,04 EURO	SCHLUSS	4.052,73

Hinweis:

Dieses Dokument enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Infineon beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u. a.: Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Infineon ist weder geplant noch übernimmt Infineon die Verpflichtung dazu.

INFINEON KALENDER

- 09.11.04 JAHRESPRESSEKONFERENZ 2004, VERÖFFENTLICHUNG DER VORLÄUFIGEN ERGEBNISSE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2004 INKL. DES 4. QUARTALS (BIS 30. SEPTEMBER 2004)
- 24.01.05 VERÖFFENTLICHUNG DER ERGEBNISSE FÜR DAS 1. QUARTAL (BIS 31. DEZEMBER) DES GESCHÄFTSJAHR 2005
- 25.01.05 HAUPTVERSAMMLUNG, MÜNCHEN, DEUTSCHLAND

IMPRESSUM

INVESTOR NEWSLETTER 9/2004

Herausgeber

Infineon Technologies AG

Investor Relations und

Finanzkommunikation

Postfach 80 09 49

81609 München

Tel.: +49 89 234-26655

Fax: +49 89 234-9552987

E-Mail: investor.relations@infineon.com

www.infineon.com/boerse

Redaktion

Investor Relations

Produktion

Newway Agentur GmbH, Frankfurt